

PCN # 20140721003
QFP パッケージ一部製品組立部材(BOM)認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、**Page 3** 記載の変更実施予定日 (**proposed 1st ship date**) 以降に予定いたしております。

変更前の製品サンプル作製は行わない為、サンプルもしくは追加データご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。お客様の受領連絡及びサンプル/追加データ依頼は担当営業にご連絡下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20140721003	PCN 日付:	07/29/2014																											
表題:	QFP パッケージ一部製品組立部材(BOM)認定																													
PCN 詳細																														
変更内容:																														
TI は、下記記載の 3 つの Group 製品について、新しい部材セットの認定を連絡します。 Group A will be converted to Cu wire only. Group B will be converted to Cu wire as well as a new mold and mount compound. Group C will be converted to Cu wire as well as a new mold compound. Change Group# A <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bond Wire / Diameter</td> <td>Au, 1.0 mil</td> <td>Cu, 0.8 mil</td> </tr> </tbody> </table> Change Group# B <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>4205442 4073520</td> <td>4211649</td> </tr> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>4042504</td> <td>4208458</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire / Diameter</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.8 mil</td> </tr> </tbody> </table> Change Group# C <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>4205442 4073520</td> <td>4211649</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire / Diameter</td> <td>Au, 0.96 mil</td> <td>Cu, 0.8 mil</td> </tr> </tbody> </table>					Current	New	Bond Wire / Diameter	Au, 1.0 mil	Cu, 0.8 mil		Current	New	Mold Compound	4205442 4073520	4211649	Mount Compound	4042504	4208458	Bond Wire / Diameter	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil		Current	New	Mold Compound	4205442 4073520	4211649	Bond Wire / Diameter	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil
	Current	New																												
Bond Wire / Diameter	Au, 1.0 mil	Cu, 0.8 mil																												
	Current	New																												
Mold Compound	4205442 4073520	4211649																												
Mount Compound	4042504	4208458																												
Bond Wire / Diameter	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil																												
	Current	New																												
Mold Compound	4205442 4073520	4211649																												
Bond Wire / Diameter	Au, 0.96 mil	Cu, 0.8 mil																												
変更理由:																														
供給能力確保 1) 業界技術動向に合わせて、向上した機械的/電気的特性のワイヤを使用します。 2) 組立/検査量産サイトの柔軟性を最大限にします。 3) Cu(銅)ワイヤは、入手及び保管がより容易になります。																														
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																														
なし																														

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等